

HAMLIN

用途说明 AN115

焊接温度

此用途说明应用于常规情况下焊接至印制电路板 (PCB) 的所有 Hamlin 产品，包括所有磁簧开关。这些组件的主要材料为金属、玻璃和热固性塑料。

焊接 Hamlin 组件与其它普通的电气组件相比，没有独特要求。以下一般焊接建议应用于除了 DRR-DTH 和 DRT-DTH 之外的所有产品：

- 表面贴装再流焊：260C 时，最多 20 秒，大于 217C 时，最多 120 秒
- 波峰焊接：270C 时，最多 10 秒。
- 手工/返修焊接：350C 时，最多 2 秒。

对于 DRR-DTH 与 DRT-DTH，焊接至磁簧开关的双线端时，应在磁簧开关与烙铁之间使用散热器。

除 DRR-DTH 与 DRT-DTH 之外的磁簧开关可在不预热的情况下在焊锡炉中镀锡或焊接。允许使用玻璃接触液料。

